

Optimale Ausnutzung
der Schneiden, unab-
hängig von der einge-
stellten Schnitttiefe

Austausch der Kassette
oder Auflageplatte anstelle
des kompletten Fräskörpers

Austauschbarkeit – Verwendung
von neuen Fräskörpern mit noch
vorhandenen, ausgelaufenen
Rundplatten 20 möglich

Seco® Rundplatte 20
Höhere Effizienz und Vielseitigkeit beim
Kopierfräsen

Optimale Schneidenausnutzung für höhere Produktivität

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten

Der Seco® Rundplatte 20 Kopierfräser ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine breite Palette von Kopierfräsanwendungen, darunter Plan-, Nut-, Tauch- und Rampfräsen. Das umfangreiche Sortiment an Wendeschneidplattensorten ermöglicht eine effiziente Bearbeitung von Stahl, Rostfrei, hitzebeständigen Superlegierungen, Gusseisen und gehärtetem Stahl.

Weil jede Schneide zählt

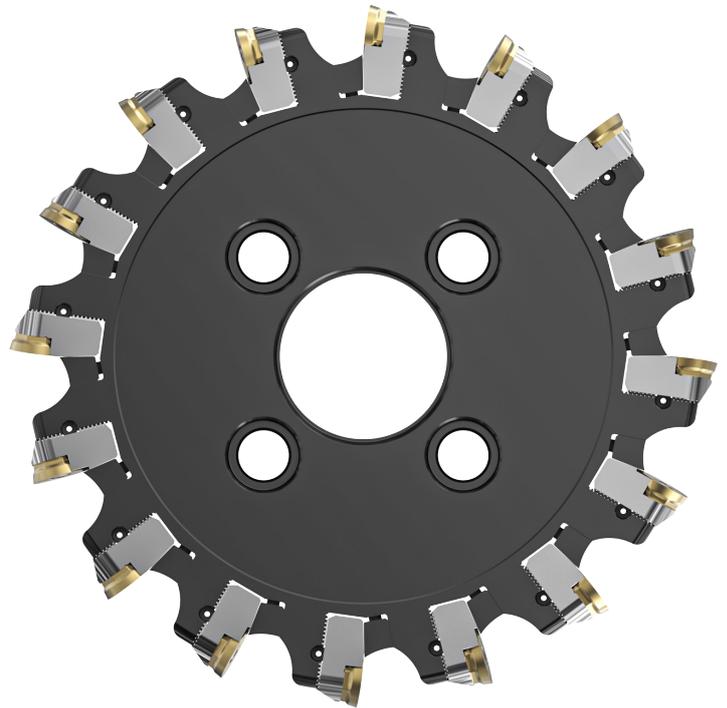
Die hohe Flexibilität dieses Systems zeigt sich nicht nur in der Bearbeitung verschiedener Werkstoffe, sondern auch in der Anpassung der Schneidenanzahl: Abhängig von der erforderlichen Schnitttiefe können die Wendeschneidplatten mit drei, vier, sechs oder acht Schneiden genutzt werden.

Reduzierung der Fertigungskosten

Durch die wirtschaftlichen Kassetten- und Auflageplattenlösungen bleibt der Fräskörper bei Plattensitzschäden erhalten. Ein einfacher Austausch der Kassette oder der Auflageplatte minimiert die Werkzeugkosten und reduziert Stillstandszeiten.

Bestehenden Bestand nutzen

Durch die Einführung des neuen Seco Rundplattenfräasers können trotzdem die noch vorhandenen, ausgelaufenen Rundplatten 20 in den neuen Fräskörpern genutzt werden. Es besteht eine Austauschbarkeit bezüglich ALT gegen NEU und umgekehrt. Profitieren Sie durch die flexible Wendeschneidplattensitzgestaltung von 6-fach oder 8-fach indexierten Wendeschneidplatten, von der Möglichkeit, unterschiedliche Schnitttiefen zu realisieren, bei optimaler Ausnutzung der Schneidkanten.



Technische Daten

Durchmesserbereich 40–250mm (2,50–3,00 inch)

**Max. Schnitttiefe/
Eckenradius:** 10mm (0,393 inch)

Aufnahmetyp: Aufsteckfräser, Combimaster & Weldon Schnittstelle

Wendeschneidplatten für: P M K S H

Einsatzbereiche: Vom Schrappfräsen mit hoher Schnitttiefe zum Hochvorschubfräsen mit reduzierter Schnitttiefe

Kompatibilität: 8-fach Indexierung kompatibel mit vorhandenen Plattensitzen
6-fach Indexierung kompatibel mit neuen Plattensitzen

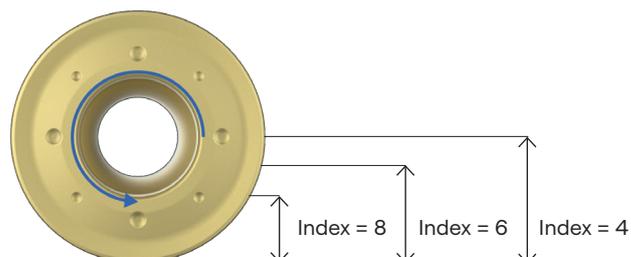


Rundplatte 20 – Arbeitsbereiche

Das Seco Rundplatte 20 Kopierfrässystem eignet sich für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Fräsanwendungen in Stahl, Rostfrei, Gusseisen, Superlegierungswerkstoffen und gehärteten Werkstoffen. Die runden Wendeschneidplatten können je nach erforderlicher Schnitttiefe auf 3 bis 8 Schneiden indexiert werden.

RP.T2006M0.-6-... Index = 3 / 6
RP.T2006M0.-8-... Index = 8 / 4

Index	APMXS	
4	10,0mm	0.393"
6	5,0mm	0.196"
8	2,9mm	0.114"





QR-Code scannen oder Klick auf den Link für weitere Informationen zum Kopierfräser Seco® Round 20

www.secotools.com/milling/copy-milling/round20



Seco® unterstützt nachhaltige Fertigungsprozesse, die gleichzeitig einen spürbaren Mehrwert für Sie als Kunden bieten. Wir recyceln alle Hartmetallprodukte, einschließlich Stangen und Unterlegscheiben, allerdings kein Stahl, Keramik oder Cermet

QR-Code scannen oder Link klicken und mehr darüber, erfahren wie Sie Recycling-Partner werden und unser Recycling-Programm nutzen

www.secotools.com/recycling

secotools.com

© Seco Tools AB, 2025.

Alle Rechte, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Technische Daten unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.